

证券代码：301510

证券简称：固高科技

固高科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	王喆 摩根大通 邱洁丽 摩根大通 苏畅 摩根大通 程潇涵 Artisan Partners 李希言 景顺长城基金 金悦奇 方瀛投资
时间	2024年11月20日
地点	深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李小虎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司对于运动控制技术、产品与行业发展有何看法？</p> <p>运动控制是一个聚焦于物理世界中物体机械运动的领域，应用面相对宽泛，在消费级产品、工业级产品，甚至是一些特种领域都有广泛的运用与出现的空间。</p> <p>结合自身禀赋，固高更多会聚焦在运控技术在高端装备领域的应用落地，最为典型的就就是半导体/泛半导体设备、数控机床、机器人等领域，众多的应用场景里在实际上都会要求到微米、纳米级别的高速高精度机构控制。</p> <p>高端装备领域的技术与产品研发、应用拓展，是企业未来五</p>

年、十年最为聚焦的战略发展方向。

2、面向高端装备提供技术与服务，如何看产业博弈的风险？

由于宏观上国际环境复杂的背景情况，全球范围内产业博弈是当下产业发展广泛存在的一个背景。固高从自身角度对此有一点理解，自身观点缺少深入印证，仅供参考：

从企业角度来看，当下产业博弈与竞争更重要的内因是随着产业结构内生发展而产生的不同阶段与需求。归结到从大数上来看，中国大陆制造业规模已达三四十万亿的规模，整个制造业内部结构转向芯片、汽车、飞机、船、火车这样高附加值领域本是产业界强大后的内生的需求，外部的博弈更多起到强化剂的作用。

作为服务于半导体芯片、汽车、飞机等高价值制造业的半导体/泛半导体设备，数控机床等高端生产工具伴随服务对象（制造业）的结构化转变必然随之呈现出强烈的需求。进而也为内部的部件、系统带来很大的需求空间。

上述产业由于发展的内生逻辑，其发展进程很难被其他因素打断，但外部力量可能会造成干扰、延缓或加速；国际上几个工业强国或地区的发展历程，也可提供相应的例证以供参考。

所以从企业角度出发，当下固高仍然专注于立足技术与产品的发展，以求更好地服务客户的需求。

3、企业如何看待机器人的机会？

机器人可能是一个巨大的产业，业内、社会都对机器人行业保有高度的预期。尤其伴随着近年人工智能的发展，许多观点把机器人认为是人工智能的落地载体。在公司看来对于机器人领域大致有以下几个认知，供参考：

一、从公司自身角度来讲，公司长期从事运动控制、伺服驱动等技术及产品研究，有较为丰富的沉淀。机器人技术与产业发展中，在机器人“小脑”、电流驱动、感知、编码器与关节等内部部件或功能单元的重合度极高。且企业自身从工业机器人、物流机器人已在机器人领域有着十多年的技术产品开发与商业活动，相关技术与产品长期服务机器人领域，并将持续跟进相关趋势变化。

二、企业认为机器人行业的健康发展，最重要还是应当发掘出高价值的商业场景。目前已经呈现的几个场景，比如扫地机器人、无人机、工业机器人、物流机器人、手术机器人、送餐机器人等，

	<p>都在尝试从价值场景中重构出机器人的构型与商业价值。当下人形承载了很高的期望，但也还需要找到适合的应用场景，呈现出自身的价值定位，才能走通商业闭环。</p> <p>三、人工智能，尤其是大模型落地到机器人以及具体应用场景，业界在对其做各种尝试，但仍然有许多工程、技术的问题在解决中。企业自身而言，更加关注并探索机理模型在特定工业现场的应用落地。</p> <p>4、在半导体设备领域，公司产品竞争格局怎样？</p> <p>从企业实际上感知来看，目前半导体/泛半导体设备内伺服控部件主要还是由ACS、Aerotech、欧姆龙、Beckhoff、ELMO等在供给；在目前的市场进程中，企业相对国际同行处于后进入状态。</p> <p>实际上，在整个半导体\泛半导体设备领域，国际主机企业仍处于主导地位，国内逐个工业节点设备突破。公司作为主机设备的部件供应，相对主机企业的进度会相对靠后。</p> <p>此外，如果分成以光刻、刻蚀、沉积为代表的前道晶圆加工设备，以键合、固晶、划片为代表的后道封测设备两大类来看。后道设备进展相对更快，很多工艺设备已经进入量产阶段。前道设备多数是量产前期，批量节点还需要跟进下游晶圆厂建设投产与主机设备的铺货进度。</p> <p>5、公司目前在半导体设备、数控系统领域有营收吗？</p> <p>企业目前在半导体/泛半导体设备领域的应用营收占比约15%的比例。这个营收以后道设备应用为主；前道设备多数还处在量产前期，在刻蚀、沉积这两类工艺设备中有配合客户进度将公司产品推进到量产阶段，但暂时数量有限，对整体营收影响有限。</p> <p>公司的数控机床与工业激光设备领域营收占比约30%，</p>
附件清单（如有）	无